

結晶加工と評価技術第 145 委員会 第 109 回研究会

日 時：2007 年 2 月 21 日（水）10：25－17：00

場 所：弘済会館 4F 菊の間

千代田区麴町5-1（電話：03-5276-0333）

（交通：JR中央線「四ッ谷駅」下車徒歩7分、

案内図：<http://www.kousaikai.or.jp/hall/>）

テーマ：次世代半導体結晶の加工と応用 ―最近の研究動向を探る―

世話人：土肥俊郎（埼玉大学），山内和人（大阪大学）

<プログラム>

セッション1：次世代半導体結晶および応用技術の現状と将来（座長：土肥俊郎）

10:25-10:30 あいさつ

梅野正隆（福井工大）

10:30-11:15 市場動向の分析：半導体産業と自動車産業の関わりと今後の見通し

泉谷 渉（半導体産業新聞 編集局長）

11:15-12:00 キーノートトーク：ワイドギャップ半導体結晶基板の現状と将来展望

吉田貞史（埼玉大学工学部）

12:00-13:00 昼食休憩

セッション2：加工および応用技術に関する研究動向 I（座長：土肥俊郎）

13:00-13:40 自動車産業におけるGaNデバイスの現状と将来

加地 徹（豊田中央研究所）

13:40-14:10 高能率SiCウエハ製造プロセス

加藤智久（産業技術総合研究所）

14:10-14:40 触媒基準エッチング法によるSiC, GaN基板の加工

佐野泰久、山内和人（大阪大学大学院工学研究科）

14:40-15:10 休憩

セッション3：加工および応用技術に関する研究動向 II（座長：山内和人）

15:10-15:40 雰囲気制御型CMP法とSiC基板加工への適用

土肥俊郎（埼玉大学教育学部）

15:40-16:20 SiC結晶マイクロマシーニング技術とMEMSへの適用

須田 淳（京都大学大学院工学研究科）

16:20-17:00 MEMSの最先端とSiC-MEMS

田中秀治（東北大学大学院工学研究科）

17:00-19:00 懇親会 桜の間：会費3,000円（当日受付にて申し受けます）